


(주)이노글로벌

개 요	회사명	(주)이노글로벌	설립일	2014.09.16
	대표이사	이은주	소재지	광주광역시 북구 첨단과기로 123
	자본금	400백만원	업종	전기전자
기 술	학교	광주과학기술원(GIST)	개발자(소속)	고도경 교수(광공항응용물리학과)
	기술완성단계	시제품 제작 및 평가	참여형태	기술이전
파 트 너 사	회사명	-	사업분야	-

사업 개요

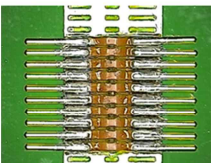
기술 요약	<ul style="list-style-type: none"> 경쟁기술(핀방식,실리콘방식)의 장점을 결합해 차별적인 테스트 소켓 기술 개발, 고출력 레이저 커팅 기술을 적용하여 0.3mm이하의 초정밀 미세 피치용 핀 제조 FPCB에 패턴을 형성한 뒤 상하단에 핀을 배치하여 그 안에 실리콘 채워넣은 후, 초정밀 레이저 가공기술을 통해 미세하게 핀을 커팅하는 방식 Barrel(몸통)과 스프링을 이용하지 않아 단가를 낮추고, 초정밀 레이저 커팅기술을 통해 0.3mm이하의 Fine Pitch에 대응 가능
시장 현황	<ul style="list-style-type: none"> 세계 반도체 시장은 웨어러블 디바이스와 IoT 시장 개화로 성장세 회복 중 반도체 성장에 따라 반도체 테스트 소켓 또한 동반 성장 국내 테스트 소켓 시장은 현재 2,500억원에서 16년 2,700억원 수준으로 성장 전망
사업화 계획	<ul style="list-style-type: none"> 1단계(초기) 특수 반도체 영역 진출 (고사양 카메라 모듈 테스트 및 반도체 시장과 자동차 전장) 2단계(중장기) 향후 펄스 레이저 가공기술을 토대로 메모리 반도체용 0.15mm 이하의 초정밀 미세 pitch 시장 진입

BEFORE CUTTING

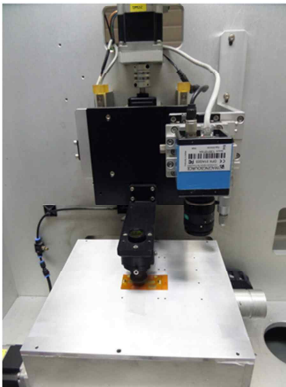


실리콘

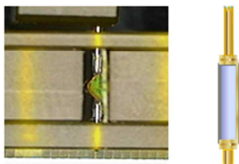
AFTER CUTTING



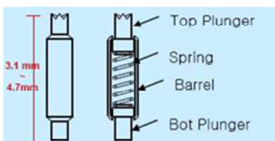
LASER CUTTING SYSTEM



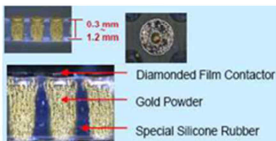
INNO 방식



PROBE PIN



SILICONE RUBBER



<레이저 커팅 시스템 및 커팅 전후 비교 > <기존 제품 방식과 이노 제품 비교>